



KOMMUNIKATIONSTECHNIK

ANWENDUNGSBEISPIEL

Standard- und kundenspezifische Gehäusekomponenten gut kombiniert

Für einen Anbieter von Kommunikationslösungen hat HEITEC ein kosteneffizientes Gehäuse realisiert, das weitestgehend Standardkomponenten verwendet, aber soweit modifiziert wurde, wie es nötig und bedarfsgerecht war.

Digitale Alarm- und Kommunikationsserver erleichtern und beschleunigen Kommunikationsabläufe, schützen und alarmieren, lassen Mitarbeiter mobiler werden, optimieren die telefonische und multimediale Erreichbarkeit und automatisieren wiederkehrende Prozesse. Solche Systeme werden in vielen Branchen eingesetzt, wie etwa Gesundheitswesen, Energieversorgung, Transport und Verkehr, Finanzdienstleistungen und bei öffentlichen Einrichtungen. Unterschiedlichste Funktionen ermöglichen ereignisbasierte und automatisierte Kommunikationsprozesse wie Rundrufe und Alarmierungen von Personen, Personensicherungsfunktionen, Krisenkonferenzen sowie erweiterte Alarmfunktionen für Rettungsdienste.

Die komplexe und spezialisierte Server-Elektronik ermöglicht hochverfügbare und sehr betriebsstabile Lösungen. Eine große Packungsdichte der Elektronik sowie unterschiedliche auf den Einsatzzweck abgestimmte Bauformen definieren den „Rahmen“ für das Gerätegehäuse. Das Ergebnis ist ein mit Griffen versehenes 19-Zoll-Tischgehäuse, basierend auf dem HeiPac Vario-Modul, das

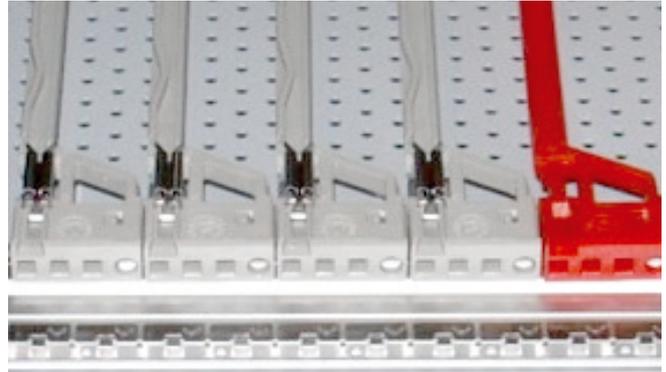
sich bei Bedarf in einen Serverschrank einbauen lässt und das der Endkunde ergonomisch und gut an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen kann. Neben dem Gehäuseaufbau und der Integration der Elektronik war HEITEC auch für die Qualitätssicherung sowie für mechanische Funktionstests verantwortlich.

Auch spezielle Kundenwünsche, wie etwa eine an das Corporate Design des Kunden angepasste Frontplatte, konnten schnell umgesetzt werden. Der Gehäusegrundaufbau, wie etwa die Seitenwände, ist in 19-Zoll-Technik ausgeführt, die Profilschienen sind ebenfalls standardisiert. Auf diese Weise konnte der Bauraum für die gewünschte Einteilung schnell und kostengünstig geschaffen werden. Die Kartenführungen wurden nach Anforderungen des Kunden hinsichtlich der Bestückung ausgerichtet. Spezielle gelochte Boden- und Deckbleche wurden entwickelt und verbaut, um eine optimale passive Belüftung der dicht gepackten Elektronik ohne zusätzliche Ventilatoren zu ermöglichen und gleichzeitig die Anforderungen an die elektrische und mechanische Sicherheit sowie an die EMV zu erfüllen. Außerdem konnte durch die Lochung mit einem Lochdurchmesser von 2,0 mm die geforderte UL-Zulassung erreicht werden.

Standard vs. kundenspezifisch – Das Beste aus beiden Welten



Speziell gelochtes Bodenblech mit 2,0 mm Lochdurchmesser für UL-Zulassung



Nach Kundenanforderungen ausgerichtete codierbare Kartenführungen mit ESD-Federn

Technische Kurzbeschreibung

- › Tischgehäuse HeiPac Vario-Modul
- › T x B x H: 245 mm x 84TE x 3HE
- › Codierbare Kartenführungen mit ESD-Clips
LP = 160 x 2,00 mm
- › Bodenblech mit Lochung von 2,0 mm Lochdurchmesser
- › Schutzart IP40

Kundenvorteile

- › Maßgeschneidertes Tischgehäuse für kundenspezifisches System
- › Guter Schutz vor Umgebungsbedingungen (IP40)
- › Komplette Gehäuselösung mit integrierter Backplane und Kabelbaum, Qualitätssicherung und Funktionstests aus einer Hand
- › Spezielle Anpassungen an Corporate Design Vorgaben
- › Maximaler Bauraum für komplexe Server-Elektronik
- › Hoher EMV-Schutz
- › UL-Zulassung
- › Kostenoptimierte Gehäuselösung
- › Speziell auf Kundenbedürfnisse angepasstes Logistik-konzept (z.B. kurzfristige Verfügbarkeit)

HEITEC AG

Dr.-Otto-Leich-Str. 16
90542 Eckental

Telefon: +49 9126 2934 0

Fax: +49 9126 2934 199

E-Mail: elektronik@heitec.de

Internet: www.heitec-elektronik.de